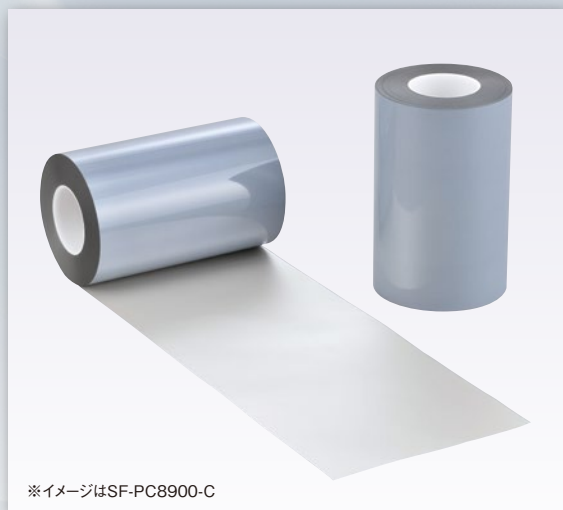


高周波対応/高周波対応薄型タイプ



※イメージはSF-PC8900-C

SF-PC[®]8600-C SF-PC[®]8900-C

高周波領域においても高いシールド特性を発揮できる
シールドフィルム

SF-PC5600-C/5900-Cを上回るシールド特性を備えています。
FPC構造に準じて厚みごとに使い分けが可能です。

特徴

▶ 高シールド特性

高周波においても高いシールド特性を有する

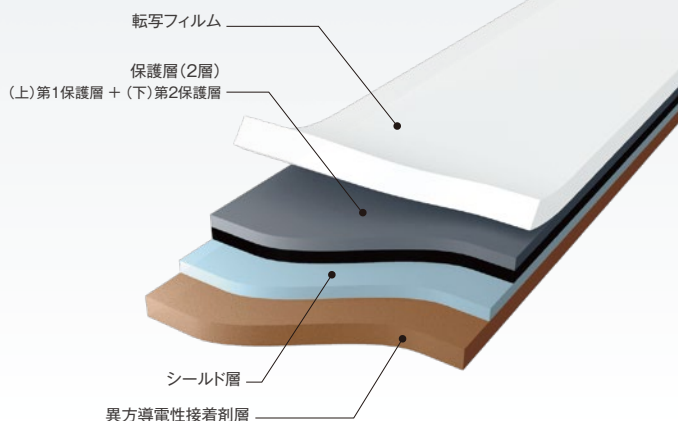
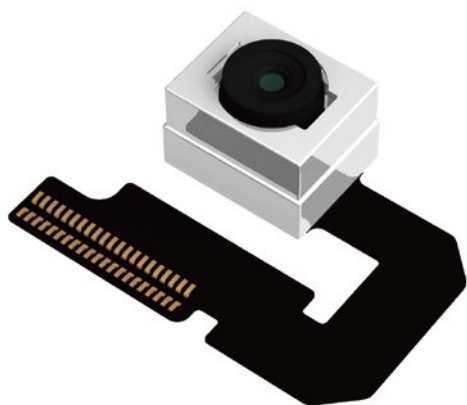
▶ 優れた作業性

高シールド特性を備えつつも、従来品と同等の作業性を維持

こんなところで活躍します

高画素タイプのカメラモジュールにも対応

金属薄膜層の厚みを上げることで、従来品と同等の屈曲性・作業性を維持しつつ、高周波領域におけるシールド特性も向上しました。



代表スペック	SF-PC8600-C	SF-PC8900-C
転写フィルム厚み	57μm(白色)	57μm (白色)
製品総厚み(プレス後)	15μm	8μm
保護層厚み	5μm	5μm
シールド層厚み	0.3μm	0.3μm
異方導電性接着剤層厚み	10μm	3μm
接着強度	3.0N/cm以上	3.0N/cm以上
製品ライフ(冷蔵)	6ヶ月	6ヶ月

※接着剤層の保護フィルムはオプションにて別途承ります。